

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装
研发项目（补充验收 1 台铜硅抛光一体机）”
竣工环保验收专家意见

根据国务院《建设项目环境管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、第二十四号主席令（2018 年 12 月 29 号）的要求，2019 年 6 月 11 日，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称该公司）在公司内主持召开了“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目（补充验收 1 台铜硅抛光一体机）”（以下简称本项目）环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位等单位代表共 7 人，会议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告及批复，踏勘了工程现场，听取了建设单位关于项目基本情况介绍、监测单位对于竣工验收监测情况的介绍，经认真讨论形成如下专家意见：

一、项目基本情况

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司成立于 2012 年 9 月，位于无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D1 栋，由中科院微电子所和集成电路封装产业龙头企业长电科技、通富微电、华天科技、深南电路、苏州晶方、安捷利（苏州）、中科物联、兴森快捷、国家开发银行十家单位共同投资而建立。

该公司现有项目“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目”，其环评报告表已于 2015 年 7 月 20 日通过无锡市环境保护局（锡环表新复[2015]143 号）审批。以上项目已于 2016 年 6 月 27 日通过无锡市环境保护局（锡环管新验[2016]97 号）审批。但当时验收中以下设备未到位：铜硅抛光一体机 1 台、表面贴装锡膏印刷机 1 台、电化学沉积台 1 台、凸点自动检测仪 1 台、晶圆级封装自动测试机 1 台，故当时验收内容不包括以上设备。此后，1 台电化学沉积台设备到位，已于 2019 年 2 月完成水、气、声、固体废弃物竣工环保验收。

如今，该公司 1 台铜硅抛光一体机已如环评申报数量到位，其他设备仍未到位，故本次验收是对“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目”的补充验收，即为本项目，本次验收范围为“铜硅抛光一体机生产设备 1 台”对应的环保验收。

本项目已于 2019 年 4 月开始生产调试。2019 年 4 月 24 日~25 日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。

二、工程变动情况

经核对，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备和数量、污染防治措施与环评和批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目只针对一台铜硅抛光一体机，其对应生产工序为“研磨”。在此生产设备不工作期间，用纯水保持其处于湿润状态，此纯水循环使用，只补充损耗不

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂水、气（无）污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查，项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，符合竣工环保验收条件。建议本项目水、气、声污染防治设施通过竣工环保自主验收。

专家组签名：张如美 邹 华



2019/6/11



华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目

(补充验收 1 台铜硅抛光一体机)” 竣工环保验收会议签到表

评审时间：2019 年 6 月 11 日

姓名	单位	职称 职务	联系方式	身份证号码
张北志	无锡市环境工程总承包中心	总工	13921527297	321002196901170927
邵平	江南大学	教授	13812085019	32020319721216147
张华之	天分新材料科技有限公司	副经理	15852891455	
杨朝	无锡指环新材料科技有限公司	副总	13915289172	320202197401100572
孙伟	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	副总	13701511601	320106196702271258
王明	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	EHS	13951568906	320203196206030319
陈亮	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	经理	18661052561	352227198001070553